

IE-PCB-SPM-P-180-SMD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



SPElink®



PCB zásuvky pro jednopárový kabel Ethernet

Jednopárový Ethernet je technologie, která k přenosu dat a elektřiny vyžaduje pouze jeden pár vodičů.

Díky těmto výhodám bude SPE upřednostňovanou sítí nejen v terénu.

Výhody jednopárového Ethernetu:

- Konzistentnost: jednopárový Ethernet umožňuje jednotnou komunikaci v síti Ethernet od snímače až po cloud
- Nadčasovost: klíčová technologie pro Průmysl 4.0 a IIoT
- Flexibilita: dosah až 1000 m a přenosová rychlost až 1 GB/s umožňuje využití napříč aplikacemi
- Inovace: lehčí, zabere menší prostor a snižuje nároky na instalaci

Všeobecné objednací údaje

Verze	Vestavěné zástrčky, Vložka M8 PCB, IP67 s pouz- drem, Pájené připojení SMD, 180°, Počet pólů: 2
Objednací číslo	2795110000
Typ	IE-PCB-SPM-P-180-SMD
GTIN (EAN)	4064675119166
Množství	100 ks

IE-PCB-SPM-P-180-SMD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	14,5 mm	Hloubka (v palcích)	0,571 inch
Výška	22,1 mm	Výška (v palcích)	0,87 inch
Šířka	10,1 mm	Šířka (v palcích)	0,398 inch
Čistá hmotnost	5,14 g		

Teploty

Provozní teplota	-40 °C...85 °C
------------------	----------------

Balení

Délka VPE	327 mm	Šířka VPE	327 mm
Výška VPE	52 mm		

Specifikace systému

Cykly zapojování	≥ 100	Kategorie	T1-B
Kategorie výkonu	T1-B	Montáž na PCB desku	Pájené připojení SMD
Počet pólů	2	Proces pájení	Pájení přetavením, Manuální pájení
Skupina produktů	Ethernet v průmyslovém prostředí	Stupeň krytí	IP67 s pouzdem
Výstupní tvarovka	180°		

Elektrické vlastnosti

Izolační síla	≥ 500 MΩ	Jmenovité napětí	72 V
Jmenovitý proud	4 A		

Standardy

Standardní konektor	IEC 63171-5
---------------------	-------------

Údaje o materiálu

Izolační materiál	LCP	Barevný	černá
Barevný graf (podobné)	RAL 9011	Izolační síla	≥ 500 MΩ
Moisture Level (MSL)	1	Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0
Materiál kontaktu	Slitina	Povrch kontaktu	Ni/Au
Provozní teplota, min.	-40 °C	Provozní teplota, max.	85 °C

Klasifikace

ETIM 6.0	EC002637	ETIM 7.0	EC002637
ETIM 8.0	EC002637	ETIM 9.0	EC002637
ECLASS 9.0	27-44-04-02	ECLASS 9.1	27-44-04-02
ECLASS 10.0	27-44-04-02	ECLASS 11.0	27-46-02-01
ECLASS 12.0	27-46-02-01	ECLASS 13.0	27-46-02-01

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

IE-PCB-SPM-P-180-SMD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Soubory ke stažení

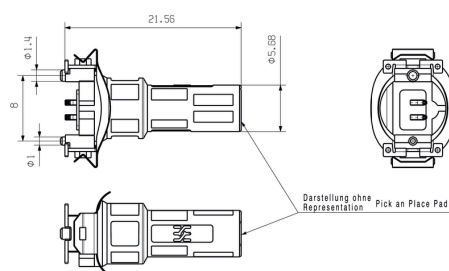
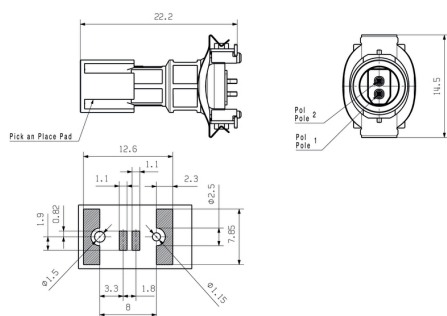
Technické údaje	CAD data – STEP
Technická dokumentace	IE-PCB-SPM-P-180-SMD
Katalogy	Catalogues in PDF-format

IE-PCB-SPM-P-180-SMD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Nákresy



Recommended reflow soldering profile

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Reflow soldering profile

The perfect soldering profile for SMT Surface Mount Technology is one the most exiting question in SMT production. But there are more than one correct answer: The diagram of temperature-on-time is related to processing features of solder paste and to maximum load of components.

We have to consider the following parameters:

- Time for pre heating
- Maximum temperature
- Time above melting point
- Time for cooling
- Maximum heating rate
- Maximum cooling rate

We recommend a typical solder profile with associated process limits. With preheating components and board are prepared smoothly for the solder phase. Heating rate is typically $\leq +3\text{K/s}$. In parallel the solder paste is 'activated'. The time above melting point of 217°C the paste gets liquid and components and boards begin to connect. The maximum temperature of 245°C to 254°C should stay between 10 and 40 seconds. In the cooling phase at $\geq -6\text{K/s}$ solder is cured. Board and components cool down while avoiding cold cracks.